

2022年6月30日 電子デバイス研修講座(専門講座)：WEB配信併用

電子デバイス研修講座(専門講座)：WEB併用		
キャッチフレーズ	<p align="center">実装技術の進化 第二回 ～ 先端実装技術と半導体産業構造の変化を考える ～</p> <p>3Dパッケージング技術と実装技術が今後の半導体産業の発展に重要な役割を果たすようになってきました。証券会社のアナリストの見方、5Gスマホ・自動運転に必要な技術、欧米の技術開発状況を確認しながら今後の産業構造と技術動向を議論したいと考えています。 専門講座として第二回に当たるため実装技術の永遠の課題の一つ"放熱技術"についてもわかりやすく解説していただきます。</p>	
対象者	半導体パッケージングと実装技術の、材料、装置、プロセスに関するの中堅・経験のあるエンジニアと事業企画ご担当 同時に半導体のユーザーや電子機器のセットメーカーの方にとってもお役に立つと考えています。	
会場	学士会館 号室	
WEB参加の場合	Teamsを使用しURLを送付し、接続していただきます。	
6月30日 (木)	10:10-11:00	半導体実装技術の推移と技術課題
	加藤凡典	有限会社 エー・アイ・ティ
	1960年代に日本でも製造が始まった半導体のパッケージング及び実装技術の推移と現在抱えている技術課題について整理します。	
	11:10-12:20	証券市場から見る半導体産業構造の変化
	山本義継	みずほ証券
	半導体実装にかかわる装置・材料メーカーの今後と産業構造の変化について証券アナリストとしてコメントしていただきます。	
	12:20-13:10	昼食・昼休み
	13:10-14:20	5Gスマホ及び自動運転における実装技術のキーポイント
	上田弘孝	セミコンサルト
	5G用スマホ及び自動運転には新しい実装技術が多く使われています。本格的5Gの時代に向けて必要となる実装技術のキーポイントを解説していただきます。	
	14:30-16:00	ヘテロジニアス・インテグレーション
	宇都宮久修	インターコネクションテクノロジー
	アメリカおよびヨーロッパにおけるIntel, AMD, IZM, などの chipletの現状などヘテロジニアスインテグレーションの現状を解説して頂きます。	
16:10-16:50	電子機器における熱放散技術	
横内貴志男	関東学院大学 IEEE	
実装技術の中で常に抱えているテーマが放熱技術です。 スパコンの放熱技術に直接携わった横内氏に熱放散技術について解説していただきます。		